# 技術紹介

# AI を用いた画像計測自動化



Nomura Kyohei

Kondo Naomi

沂藤

Tanakamaru Tempei

Sato Katsuhiro

佐藤 雄大 Hata Nobuyoshi

Sakakibara Yohei

当社では、検査・計測の作業効率化および作業者によるばらつきの低減、技術伝承補助といった付加価 値向上を目指して AI による各種金属組織特徴抽出システム開発を進めている。

本稿ではそれら取り組みの 1 つとして、火力発電ボイラで用いられているフェライト系耐熱鋼のクリー プボイドについて、画像生成 AI である pix2pix を用い、ボイドを含む SEM 画像よりボイドの判定ならび にそのボイド領域の自動計測を試みた。その結果、作成した 4 種類の AI モデルのうち、寿命の初期、中期、 後期を分類せず、かつ SEM の元画像を「回転 + 反転」によりデータ拡張して得られたモデルで評価指数 F が最も高い値を示した。一方、コントラストが低い SEM 画像ではボイド検出精度が低下する傾向があ ることも確認された。コントラストが低い SEM 画像については、画像の明るさ / コントラストを調整す ることでボイドの検出精度が向上することも確認した。

キーワード: AI、画像自動計測、pix2pix、クリープボイド、電子顕微鏡、SEM 画像、 評価指数 F、画像処理、明るさ / コントラスト範囲

### **1.** はじめに

金属材料の機械特性は材料自身を構成する金 属組織に依存し、機械製品の設計から製品使用開 始後の保守、損傷発生時の原因究明などさまざ まな場面で重要な情報として収集・活用されてい る。それら金属組織情報は一般に金相試験にて 取得され、当社でも検査・計測事業における材料

調査サービスの一環(1)として、試験室では製品 ないしサンプルの切断面から、現地では Suzuki's Universal Micro Printing Method (SUMP 法: 各種製品表面の金属組織をフィルム等に転写させ て非破壊的に観察する手法。SUMP 法にて金属組 織を転写したフィルム等を以降レプリカと称す) により製品表面から金属組織情報を取得するサー

- \*1:計測事業部 化学・材料部 材料グループ グループ長 工学博士
- \*2:計測事業部 化学・材料部 磯子グループ 主査
- \*3:制御システム事業部 産業システム部 製品・サービスグループ
- \*4:研究開発センター 研究管理グループ グループ長
- \*5:株式会社IHI 技術開発本部 技術基盤センター 材料・構造技術部
- \*6:株式会社IHI 技術開発本部 技術基盤センター 材料・構造技術部 主幹 工学博士

ビスを提供している。また昨今では、検査・計測 の作業効率化および作業者によるばらつきの低 減、技術伝承補助などの付加価値向上を目指し、 前述した金属組織から AI による材料組織の特徴 を抽出するシステム開発にも取り組んでいる (2)。

一方、火力発電ボイラで用いられるフェライト 系耐熱材料では、プラント運転に伴い、特に溶接 継手の熱影響部においてクリープボイドと呼ばれ る材料劣化が発生・増加し(3)、その発生量を定 量的に把握することが発電プラントの安定運用に 重要となる。ボイドの定量把握方法としては、定 期検査等にてボイラ配管の表面レプリカを採取 し、光学顕微鏡や電子顕微鏡を用いて観察、得ら れた画像よりボイドの個数密度や面積率等の情報 を定量化する手法があり(4)、それらの情報を用 いて使用材料の寿命評価が行われている。このよ うなボイドの観察・評価はこれまで熟練技術者に より実施されてきたが、今後少子高齢化がより進 んでいくことが見込まれており、ボイドを定量評 価するための熟練技術者の確保や技術伝承がより 困難な状況となっている。この解決策の一つとし て、当社で取り組んでいる AI 技術を用いてボイド 定量を行うことができれば、前述した技術伝承・ 維持に役立てることができる。

本稿では当社で取り組んだ AI を用いたボイド 計測の自動化について、その検討結果を紹介する。 具体的には、画像生成 AI である pix2pix <sup>(2)・(5)</sup> を用い、火力発電ボイラで用いられているフェラ イト系耐熱鋼のクリープボイドについて、走査型 電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope: SEM) を用いて取得した SEM 画像よりボイド の判定ならびにそのボイド領域の自動計測を試 みた。

## 2. AI 技術 pix2pix の学習条件 および評価方法

pix2pix (5) は画像を与えて新たな画像を生成 する AI 技術の 1 つである。詳細は前稿<sup>(2)</sup> を参 照のこと。本稿では前稿同様、表面情報を転写

して得たレプリカについて、走査型電子顕微鏡を 用いて SEM 画像を取得し、pix2pix に与えた。 pix2pix ではボイドのみを抽出した白黒画像を生 成させた後、ボイドの正解画像と比較・評価した。

#### 2.1 学習データおよび学習方法

AI モデルを構築するにあたり、使用データと してグレースケールの SEM 画像 (代表例: 図1) とその画像を熟練技術者が目視しボイドとして抽 出した部分を白色に塗りつぶした白黒2値化画像 (ボイド正解画像) の組み合わせを 48 組用意し (1 組の学習データは SEM 画像とボイド正解画像各 100枚、48組のデータ中には材料の寿命消費率 が初期~後期までの幅広い範囲のデータを準備)、 このうち 46 組を学習データに、2 組を AI モデル の検証データとして割り当てた。SEM 画像およ びボイド正解画像のサイズは画像1枚あたり 1280 × 960 [pixel] である。学習時は SEM 画 像とボイド正解画像を 128 × 96 [pixel] ごと に分割し、分割した各画像を AI モデルへ入力し た。学習方法については既稿(2)をベースとしたが、 学習画像数の拡張も行った。また、学習回数は 30 エポックとした。

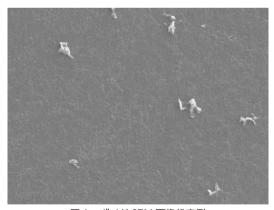


図 1 ボイド SEM 画像代表例

### 2.2 AI 出力結果の正誤判定および 精度評価

統計解析で使用される評価指数 F 値 (6) を用 いて検証データよりAIが生成した画像と正解 画像の比較を行った。AI出力結果の正誤判定は

#### 表 1 正誤判定の分類

ボイドの判定	検証(正解)画像あり	検証(正解)画像なし
AI がありと判定	<b>TP</b> (ボイドとして検出した - 正解)	FP(過検出)
AI がなしと判定	FN (検出漏れ)	TN(ボイドとして検出しなかった - 正解)

適合率 P: AI が 「あり」 と判断したもののうち、検証画像も 「あり」 だった割合

P = TP/(TP+FP)... (1)

再現率 R:検証画像が「あり」であるもののうち、AIが「あり」と判断した割合

R = TP/(TP+FN)... (2)

評価指数F:PとRの調和平均であり、 $0\sim1.0$ の値で示される。PとRが 1.0 の場合、Fも 1.0 となる

 $F = 2 \{PxR/(P+R)\} \cdots (3)$ 

表1に示す4種類に分類し、評価指数 F値は上 記式 (1) ~ (3) により算出した。

以上を評価指針とし、次章以降、検証結果を 述べる。なお、適合率 P はその値が 1.0 に近いほ どボイドの過検出が少なく、再現率Rはその値が 1.0 に近いほどボイドの検出漏れが少ないことを 意味する。従って、いずれの値も高く、かつ評価 指数 F が高いものほど AI として良いモデルが作 成されたと判断することができる。

# 3. pix2pix を用いた AI モデルの

#### 3.1 評価精度に及ぼす学習データパター ンの影響

46 組の学習データを全て与えたパターンおよ び寿命初期のみの12組、中期のみの22組、後 期のみの12組をそれぞれ与えたパターンの計

4 種類の学習データパターンにて pix2pix による AI モデルを作成し、No.1 および2の2組の検 証データにて各 AI モデルの評価精度を検証した。 各検証データの違いは No.2 の方が No.1 よりコ ントラストが高くボイドと素地の境界が明確な点 である。また、検証データ No.1 および 2 はいず れも寿命の初期となる検証データである。

AIモデルごとの精度検証結果を表2に示す。 コントラストの低い No.1 では学習データパターン により適合率 P および再現率 R が変化し、全デー タ使用または、寿命後期のみの学習データパター ンにおいて評価指数 F が高い値を示した。一方で コントラストの高い No.2 では学習データパターン による適合率Pおよび再現率Rの変化は僅かであっ た。双方の結果を踏まえると、学習データパター ンは全ての学習データを使用することが望ましい と言える。加えて、コントラストは高い方が検証 精度も高くなる傾向があることも確認された。

表 2 各 AI モデルによる精度検証結果一覧

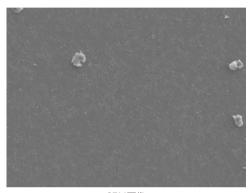
検証 データ	学習データ パターン		正解値との	)重ね合わせ紀	適合率	再現率	評価指数 F		
		正解ボイド	出力ボイド	一致 赤 TP	過検出 青 FP	検出漏れ 緑 FN	P 過検出 少	R 検出漏れ 少	F
	全データ	110694	49718	41114	8604	69580	0.827	0.371	0.513
No.1	寿命初期	110694	44098	33959	10139	76735	0.770	0.307	0.439
	寿命中期	110694	77209	33362	43847	77332	0.432	0.301	0.355
	寿命後期	110694	101952	63413	38539	47281	0.622	0.573	0.596
No.2	全データ	160374	164169	125536	38633	34838	0.765	0.783	0.774
	寿命初期	160374	171105	123374	47731	37000	0.721	0.769	0.744
	寿命中期	160374	165414	120612	44802	39762	0.729	0.752	0.740
	寿命後期	160374	191809	130198	61611	30176	0.679	0.812	0.739

次に、46 組の全データにて学習した AI モデル においてどのような場合に AI がボイドの検出漏 れ、ないし過検出するか確認した。正誤判定は、 AIで生成した2値化画像と正解画像を比較し、 正解を赤、検出漏れを緑、過検出を青で描画させ た。コントラストの低い No.1 の検証データにつ いて、SEM 画像および AI により生成された 2 値 化画像とボイド正解画像の比較画像代表例を図2

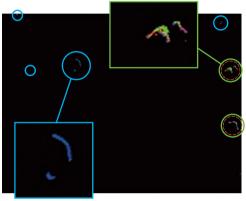
に示す。コントラストの低い No.1 のデータでは、 AIは明るさの低い粒子や素地部分を渦検出し、ま た、ボイドの明るさが高い部分の近傍で検出漏れ する傾向がみられた。

### 3.2 評価精度に及ぼす学習データ拡張の 影響

3.1 項の検証データ No.1 および 2 のいずれに



SEM画像



検証データとAIの重ね合わせ

	正解画像あり	正解画像なし
AI がありと判定	<b>TP</b> (ボイドとして検出した - 正解)	FP(過検出)
AI がなしと判定	FN(検出漏れ)	<b>TN</b> (ボイドとして検出しなかった - 正解)

図 2 SEM 画像および AI により生成された 2 値化画像とボイド正解画像の比較画像代表例(検証データ No.1)

表 3 学習データのボイド画像拡張による評価精度検証結果一覧

検証	AI 学習条件	正解値との重ね合わせ結果 [pixel]					適合率	再現率	評価指数F
データ		正解 ボイド	出力 ボイド	一致 赤 <b>TP</b>	過検出 青 FP	検出漏れ 緑 FN	P 過検出 少	R 検出漏れ 少	F
	水増し なし	有効なモデルを生成できず							
	反転のみ	111898	143670	65709	77961	46189	0.457	0.587	0.514
	回転のみ	111898	71409	56236	15173	55662	0.788	0.503	0.614
No.1	回転 + 傾斜	111898	63458	49797	13661	62101	0.785	0.445	0.568
110.1	回転 + 反転	111898	72579	58398	14181	53500	0.805	0.522	0.633
	傾斜 + 伸長	111898	106112	75290	30822	36608	0.710	0.673	0.691
	回転 + 反転 + 傾斜	111898	81017	60854	20163	51044	0.751	0.544	0.631
	回転 + 反転 + 傾斜 + 伸長	111898	117687	41625	76062	70273	0.354	0.372	0.363
	水増し なし	有効なモデルを生成できず							
	反転のみ	161877	275331	54871	220460	107006	0.199	0.339	0.251
	回転のみ	161877	218407	142135	76272	19742	0.651	0.878	0.748
No.2	回転 + 傾斜	161877	198875	135850	63025	26027	0.683	0.839	0.753
	回転 + 反転	161877	210015	140807	69208	21070	0.670	0.870	0.757
	傾斜 + 伸長	161877	281749	148768	132981	13109	0.528	0.919	0.671
	回転+反転+傾斜	161877	225431	143132	82299	18745	0.635	0.884	0.739
	回転 + 反転 + 傾斜 + 伸長	161877	257668	133185	124483	28692	0.517	0.823	0.635

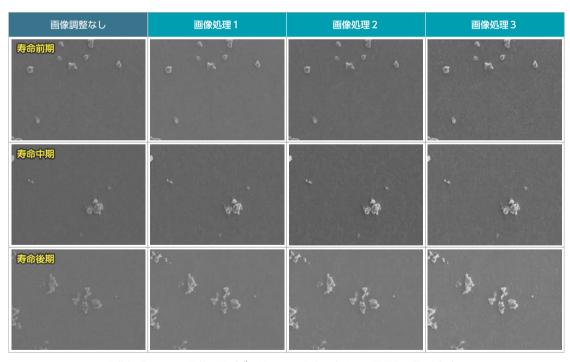
おいても学習データが最も多いモデルで評価指数 Fの値が高い結果となった。そこで、学習に用い た各データ画像に反転および回転、変形等加え、 学習データを拡張することで評価精度が向上する か検証した。学習データのボイド画像拡張による 評価精度検証結果を表3に示す。No.1 および2 でそれぞれ傾向に若干の差はあるものの、AI学習 に使用するデータ数を拡張することで適合率Pお よび再現率Rが向上、評価指数Fも高くなる傾向 がみられた。また、いずれもデータ数が多くなり すぎると適合率 P および再現率 R が低下し評価指 数Fが低下する、過学習の傾向も確認された。今 回の検討範囲では、いずれの検証データでも評価 指数 F の値が高く、かつ適合率 P および再現率 R のバランスが良かったモデルは「回転 + 反転」で 作成したモデルであった。また、No.1 および 2 の評価指数 F を比較すると、SEM 画像のコント ラストが高い No.2 の方が高い F 値を示す傾向は 3.1 項と変わらなかった。以上より、学習データ

拡張は「回転+反転」を行った場合に最も評価精 度が高くなることが確認された。また、本項で作 成された pix2pix の AI モデルでは No.1 のよう なコントラストの低い SEM 画像のボイド抽出は 不得手であることも確認された。なお、データ拡 張をせずに学習した AI モデルにおいて、有効な AI モデルが作成されなかった理由としては、視 野内に占めるボイドの比率が少なすぎたことが考 えられる。

## pix2pix を用いた AI モデルの 精度向上

## 4.1 検証データの明るさ/コントラスト (B/C) 調整による評価精度への影響

3章の検討にて本稿の学習データ量の範囲に おいて、検証データのコントラストが低い場合は 学習データ量により評価指数Fが変化し、コン トラストが高い検証データでは評価指数 F は学習



画像処理 1:B/C 調整:弱(ボイドの B/C を少し高めた:元画像に最も近い)

画像処理 2:B/C 調整:中(画像処理 1 と 3 の中間)

画像処理3:B/C調整:強(ボイドのB/Cを最も高めた:元画像から最も遠い)

図3 各検証データにおける B/C 調整前後の SEM 画像代表例

データ量にほとんど影響されなかった。すなわち、 3章にて作成した AI モデルでは適切な B/C 範囲 のデータを与えることでボイド定量における評価 精度がより向上する可能性がある。そこで、コン トラストの低い検証データを用いてそれら SEM 画像の B/C 調整を行い、評価精度の変化を確認 した。なお、B/C 調整による精度向上確認は、寿 命初期の No.1 の SEM 画像に加えて、寿命中期 および寿命後期の検証データも新たに準備し、実 施した。

表 4 B/C 調整した SEM 画像の AI による評価精度一覧

Al モデル:回転 + 反転		正解値との重ね合わせ結果 [pixel]					適合率	再現率	評価指数F
検証データ	検証画像の調整	正解 ボイド	出力 ボイド	一致 赤 <b>TP</b>	過検出 青 FP	検出漏れ 緑 FN	P 過検出 少	R 検出漏れ 少	F
	調整なし	111898	72579	58398	14181	53500	0.805	0.522	0.633
No.1	画像処理 1	111898	101857	75978	25879	35920	0.746	0.679	0.711
寿命初期	画像処理 2	111898	87808	68667	19141	43231	0.782	0.614	0.688
	画像処理3	111898	206725	103526	103199	8372	0.501	0.925	0.650
	調整なし	258360	140690	99648	41042	158712	0.708	0.386	0.499
No.3	画像処理 1	258360	231670	183459	48211	74901	0.792	0.710	0.749
寿命中期	画像処理 2	258360	279972	213855	66117	44505	0.764	0.828	0.795
	画像処理3	258360	334108	230360	103748	28000	0.689	0.892	0.778
	調整なし	575085	54037	21373	32664	553712	0.396	0.037	0.068
No.4	画像処理 1	575085	360433	318182	42251	256903	0.883	0.553	0.680
寿命後期	画像処理 2	575085	567493	440278	127215	134807	0.776	0.766	0.771
	画像処理3	575085	866373	525106	341267	49979	0.606	0.913	0.729

画像処理 1:B/C 調整:弱(ボイドの B/C を少し高めた:元画像に最も近い)

画像処理 2:B/C 調整:中(画像処理1と3の中間)

画像処理3:B/C調整:強(ボイドのB/Cを最も高めた:元画像から最も遠い)



画像処理 1:B/C 調整:弱(ボイドの B/C を少し高めた:元画像に最も近い)

画像処理 2:B/C 調整:中(画像処理 1 と 3 の中間)

画像処理 3:B/C 調整:強(ボイドの B/C を最も高めた:元画像から最も遠い)

図 4 B/C 調整した SEM 画像を用いて AI で生成した画像とボイド正解画像の比較

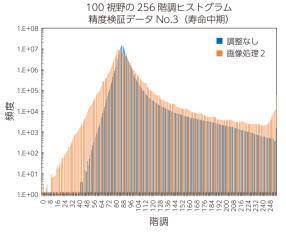
各検証データにおける B/C 調整後の SEM 画像 代表例を図3に、B/C調整したSEM画像のAI による評価精度一覧を表4に示す。画像調整なし の場合、寿命消費が大きいものほど評価指数Fは 低く、特に寿命後期である No.4 の検証データで は F 値は 0.068 となり、ボイドの検出漏れが著 しかった。一方、画像調整を行った場合では寿命 初期の検証データ No.1 では画像処理の影響がほ とんどみられなかったものの、寿命中期以降では 評価指数 F は大幅に改善し、特にボイドの検出漏 れとなる再現率 R が著しく改善された。

各検証データについて、B/C 調整した SEM 画 像を用いて AI で生成した画像とボイド正解画像 を比較した画像代表例を図4に示す。いずれの 検証データにおいても SEM 画像の B/C 調整を行 わない場合、緑色で示すボイドの検出漏れが多く 確認された。しかしながら、B/C 調整の程度を大 きくするとボイドの検出漏れは減少し、赤色で示 す正解の部分が増加していることも確認された。 また、B/C 調整の程度を過度に大きくすると青色 で示す過検出部が増加する傾向があることも確認 された。今回検討した B/C 調整においては画像 調整2の場合に赤色で示す正解の部分が最も多 く、正解画像により近い結果が得られた。また、 素地の模様についても問題なく処理できているこ とも確認された。

#### 4.2 AI に適した画像処理範囲の検討

4.1 項において、No.3 および 4 のデータを用 いた検証では SEM 画像の B/C 調整により評価指 数Fが大きく変化し、いずれにおいても画像処理 2 で評価指数 F が最も高い値となった。また、ボ イドの検出漏れおよび過検出も最も抑制されてい た。そこで、AIにて高精度にボイド検出可能な SEM 画像の B/C 範囲を明確にすることを目的と し、検証データ No.3 および 4 の SEM 元画像な らびに 4.1 項の画像処理 2 の各 100 枚ずつ、計 400 枚の画像に対してグレースケールの 256 階 調と頻度を抽出、階調分布を確認した。検証デー タ No.3 および 4 の階調分布を図 5 に示す。検証 データごとに階調分布の幅に差異はみられたもの の、いずれの検証データにおいても元画像の階 調分布形状を維持した上で階調幅を広げつつ白飛 び・黒飛び (SEM 画像中で輝度の階調が 255 を 上回る、または0を下回る領域)が抑制された階 調分布となっていた。

次に、検証データ No.3 および 4 の画像処理 2 の SEM 画像について、具体的にどの階調に対し て AI がボイド検出を行っているか確認した。結 果をそれぞれ**図6** および7に示す。検証データ No.3 (寿命中期) では、素地の明るさの階調は 平均86階調であることに対し、ボイド部の階調



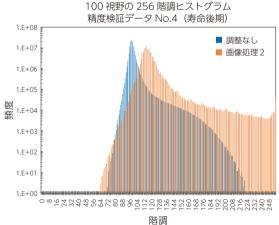


図 5 検証データ No.3 および 4 の画像処理有無による階調分布変化

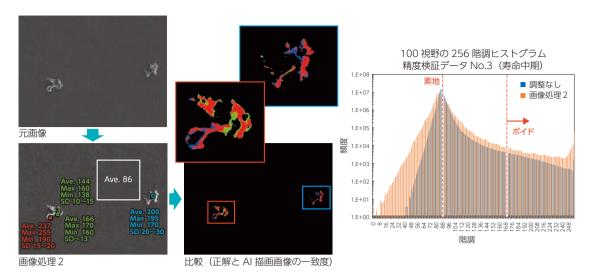


図 6 検証データ No.3 におけるボイド検出評価結果

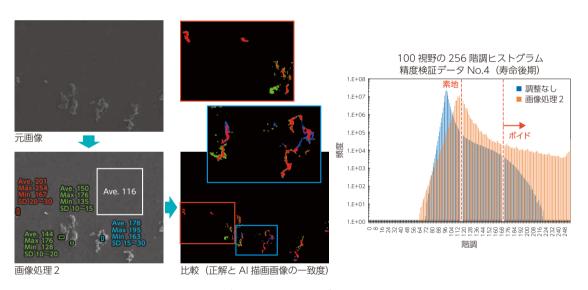


図7 検証データ No.4 におけるボイド検出評価結果

は170以上、かつ微小エリアの階調幅(コント ラスト) となる標準偏差がおおむね 15~30 程 度であった。検証データ No.4 (寿命後期) では、 素地の階調は平均116階調であることに対し、 ボイド部の階調は 160 以上、かつ微小エリアの 標準偏差がおおむね 15~30 程度であった。す なわち、AIはボイドと素地の明るさの階調差に 加えて、階調幅となる標準偏差も踏まえてボイド 検出を実施していると考えられる。

以上の結果より、本稿で作成した AI では素地

とボイドの明るさに一定量の差を持たせ、かつボ イド部全体を白飛び・黒飛びさせない SEM 画像 をインプットデータとすることでボイドの検出精 度を向上できることが明らかとなった。

## 5. まとめと今後の課題

AI を用いてボイドを自動計測することを目的 とし、AIモデルの作成およびその精度向上につ いて検討、その結果を紹介した。詳細は以下のと おりである。

#### (1) pix2pix を用いた AI モデルの検討

48 組(1 組の学習データはグレースケール の SEM 画像とボイド正解画像各 100 枚) の 全データ中、46 組を学習データとし、4 種類 の AI モデルを作成、2 組の検証データを用い て AI モデルの精度検証を実施した。その結果、 最適な AI モデルは 46 組の全学習データを使 用した AI モデルであった。

全学習データを使用した AI モデルを用いて 学習データを拡張し、評価精度への影響を検 証した結果、SEM の元画像を「回転 + 反転 | により拡張した AI モデルで最も評価指数 F が 向上することが確認された。ただし、本検討 で作成された AI モデルではコントラストの低 い SEM 画像のボイド抽出が不得手であること も確認された。

#### (2) pix2pix を用いた AI モデルの精度向上

寿命初期・中期・後期の3種類の検証デー タについて各 SEM 画像の明るさ(B) / コン トラスト (C) 調整を行い評価精度への影響 を調査した。その結果、今回検討した B/C 調 整においては SEM 元画像の B/C が AI 処理に 適していない場合でも画像の B/C 調整を行う ことでボイド計測の精度を向上可能なことを 明らかにした。また、画像調整2の場合に正 解画像に最も近い結果が得られ、素地の模様 を除外してボイド計測可能なことも確認した。

SEM 元画像と画像処理 2 を施した SEM 画

像のグレースケール階調分布を確認した結果、 今回作成した AI では素地とボイドの明るさに 一定量の差があり、かつボイド部全体を白飛 び・黒飛びさせない SEM 画像をインプット データとすることでボイド定量における評価 精度の向上が見込めることを明らかにした。

以上の結果より、今回作成した pix2pix の AI モデルは SEM 画像のボイド計測自動化に有用であ ることを確認した。今後の課題としては AI を適用 させるための SEM 画像インプットデータの明るさ / コントラスト範囲をより明確にすることである。 また、今回得られたF値が実際の画像計測に適用 可能な精度であるかは評価基準が別となるため、 ユーザーが実運用に求める性能を本 AI が満たすか 確認した上で AI 適用を進める必要もある。

#### 参考文献

- (1) IHI 検査計測ホームページ: https://www.iic-hq.co.jp/
- (2) 畑 伸佳 他:画像分析への AI 適用による検査計測技術の向上、 IIC REVIEW、No.73、2025/04、pp.40-46
- (3) 渡部 隆 他:9Cr-1Mo- V- Nb 鋼溶接継手の長時間クリープ における Type IV 破壊と微細組織、鉄と鋼、Vol.90、No.4 (2004), pp.206-212
- (4) 新田 明人: ボイラの寿命予測、安全工学、Vol.30、No.6 (1991), pp.465-471
- (5) P. Isola, J. Zhu, T. Zhou, and A. A. Efros. Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks. In Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
- (6) J. B. Brown: Classifiers and their Metrics Quantified, DOI: 10.1002/minf.201700127



計測事業部 化学・材料部 材料グループ グループ長 工学博士 野村 恭兵

TEL 045-791-3516



制御システム事業部 産業システム部 製品・サービスグループ 畑 伸佳

TEL 045-759-2487



株式会社 IHI 技術開発本部 技術基盤センター 材料・構造技術部 佐藤 雄大

TEL 070-3239-9315



計測事業部 化学・材料部 磯子グループ 主査 田中丸 天兵 TEL 045-759-2122



研究開発センター 研究管理グループ グループ長 近藤 直美

TEL 045-791-3522



株式会社 IHI 技術開発本部 技術基盤センター 材料・構造技術部 主幹 工学博士 榊原 洋平

TEL 070-3239-6601